

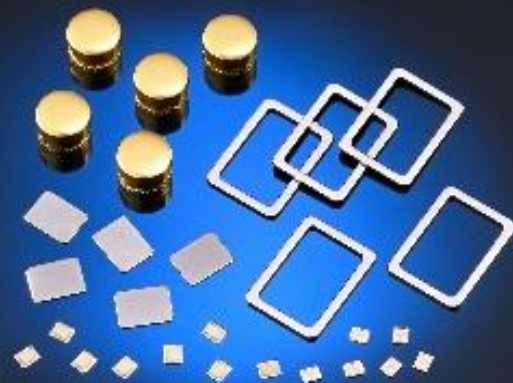
包装密封用Lid制品

作为水晶振子或SAW过滤器等SMD产品的Lid（盖）使用。
运用本公司的复合技术、电镀技术等，
可直接以低温度密封在陶瓷封装中。

提高
附加价值

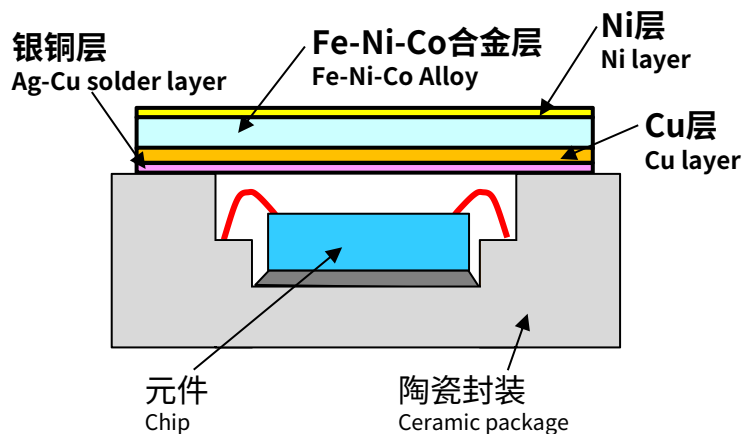
缓和
封装应力

实现
低高度化



银铜复合Lid

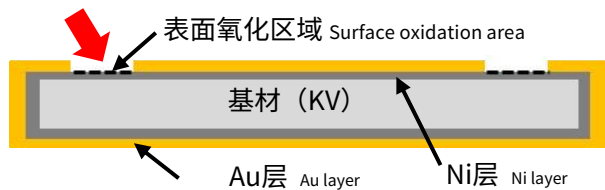
加工了4层复合材的产品。
由于将银铜作为钎料预先制成复合材，进而可直接焊到陶瓷封装。



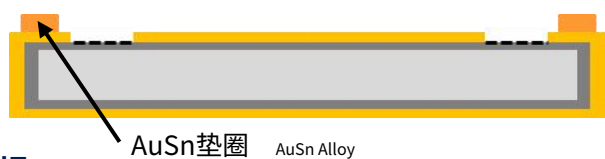
金锡（AuSn）焊盖

在KV（Fe-Ni-Co合金）基材基础上钎焊AuSn的产品。
通过激光微调技术控制AuSn钎焊区域形状，因此，能够降低AuSn量，能够进行稳定密封。

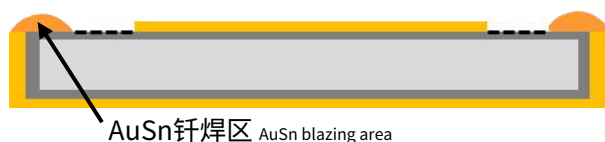
① 激光修边加工



② 钎料设置



③ 钎焊



钎焊后外观

